

2008年4月17日

シンガポール日立化成工業が 高密度・高多層配線板の生産能力を増強

日立化成工業株式会社(本社：東京、執行役社長：長瀬 寧次、資本金：154億円/以下、日立化成)の連結子会社である Hitachi Chemical (Singapore) Pte. Ltd. (本社：シンガポール、Managing Director：Lee Wee Koon、資本金：1,950万US\$/以下、シンガポール日立化成)は、サーバー、ルーター等の情報通信機器や、携帯音楽プレーヤー、ノートパソコン向けに広く使用される高密度・高多層配線板の需要を着実に取り込み、さらなる事業拡大を図るため、同社ロイヤン工場内に約30億円を投じて、延べ床面積約1万9千㎡の内層工程用の新工場を建設し、生産能力を現状比で約20%増強します。

シンガポール日立化成は、これまで主にマザーボード用多層配線板の製造をロイヤン工場(主に外層工程)、ベドック工場(主に内層工程)の2拠点で行って来ました。しかし近年、製品価格の低下や、銅を始めとする原材料価格の高騰を受け、より付加価値が高く、今後さらなる市場拡大が見込まれる高密度配線板および高多層配線板への品種転換を進めることが課題となっていました。このような状況の下、同社が目指す製品の高度化を促進するため、これまで外層工程の生産設備のあったロイヤン工場の敷地内に、新たに内層工程用の新工場を建設することにしました。

当社グループでは、4月1日より国内配線板事業の再編・統合を実施し、営業部門・事業部・開発部門を日立化成に統合することにより事業戦略の一元化とお客様窓口の一本化を図るとともに、製造拠点については子会社である日立エーアイシー(株)へ統合し、生産効率の一層の向上に努めてまいります。海外における配線板事業についても、同じく当社グループの配線板製造会社で、主に自動車やデジタル家電向けの配線板を製造する台湾日立化成工業とシンガポール日立化成との連携のもと、お客様のニーズに合わせて製造品種の棲み分けを行い、お客様にご満足いただける製品をタイムリーに供給してまいります。

<Hitachi Chemical (Singapore) Pte. Ltd.の概要> (2008年4月1日現在)

社名：Hitachi Chemical (Singapore) Pte. Ltd.

所在地：32 Loyang Way, Singapore 508730

資本金：1,950万US\$

設立：1972年11月10日

株主：日立化成工業株式会社 100%

代表者：Managing Director Lee Wee Koon

事業内容：プリント配線板の製造及び販売

今回投資額：約30億円

新工場本格稼働：2009年4月より

(報道関係お問い合わせ)

日立化成工業株式会社 社長室 広報担当 長谷川、五十嵐 TEL 03-5381-2376

<新工場完成予想図>

